

2024世界电子产品展：日本电子展

产品名称	2024世界电子产品展：日本电子展
公司名称	苏州京成展览有限公司
价格	99.00/件
规格参数	日本展会:2024
公司地址	苏州市花桥镇绿地杰作大厦9号楼1911室
联系电话	18913292209 18913292209

产品详情

2024日本电子科技博览会NEPCON JAPAN

【基本信息】

展会时间：2024年01月24-26日；东京Big Sight 展览馆

展会时间：2024年09月04-06日：东京千叶幕张展览馆

展会时间：2024年10月23-25日：名古屋展馆

展会规模：约1200家参展商；参观人数：约50000名；

主办单位：励展博览集团日本株式会社

组展单位：上海贸升展览服务有限公司--日本展会服务商

展会介绍

亚洲电子研发，制造与封装技术展会，作为“电子研发，制造与封装技术”的综合展会，NEPCON JAPAN随着日本及亚洲电子行业的发展不断成长壮大，至今已走过30多个年头。展会由电子产品制造设备及部件技术展，电子零部件检测设备及开发技术展，电子零部件封装设备及开发技术展，印刷电路展，电子元件及材料展，精密加工技术展这6个展会组成。是名副其实的“代表亚洲电子产业”的综合性展览会。NEPCON JAPAN作为了解“未来电子产业”醉新技术的绝佳场所而备受业界瞩目，吸引越来越多来自全球的参展商与观展人士汇聚一堂！

市场介绍

日本是一个高度发达的资本主义国家。其资源匮乏并极端依赖进口，发达的制造业是国民经济的主要支柱。科研、航天、制造业、教育水平均居列。此外，以动漫产业为首的文化产业和发达的旅游业也是其重要象征。据调查，日本在环境保护、资源利用等许多方面堪称世界，其国民普遍拥有良好的教育、极高的生活水平和国民素质。日本是电子工业强国，随着近年来人工智能电子工业的不断发展，日本本土的电子制造业呈现出衰退的趋势，由过去的销售快速增长到现在的依赖于电子核心部件、上游化学材料保有优势。在返个过程中，日本市场呈现出新的需求，为中国的整机产品、配套产品制造企业打入日本市场带来了良好的契机，同时也带来了广阔的合作机遇。据日本海关统计，2019年1月，日本与中国双边货物进出口额为764.0亿美元。其中，日本对中国出口340.5亿美元，总额增长14.2%；自中国进口423.5总额增长7.0%。日本与中国的贸易逆差83亿美元。中国是日本第二大出口目的地。

构成展会

NEPCON JAPAN日本电子科技博览会由六大展会组成：

1、电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN

汇集了各种电子产品制造及SMT所用设备、解决方案、技术及服务。

2、电子零部件检测设备及开发技术展ELECTROTEST JAPAN：

亚洲的电子研发制造领域有关测试，检查，测量和分析技术的展会。

3、电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging TechnologyEXP

亚洲的集成电路制造展！汇集了各种先进的设备、材料及服务。

4、电子元件及材料展ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALSEXPO

亚洲！汇集各种电子元件和材料

5、印刷电路展PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo

装配设备、保证材料/组件、IC封装汇集了如PCB材料，设计开发委托服务与设计工具软件等各种PCBs/PWBs及技术。

6、精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO

电子制造领域精密加工技术专门展！诸如模具制造、切削、冲压加工、蚀刻等各种精密·微细加工技术汇聚一堂！

展览范围

电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN：

贴片机、点胶机、焊接设备/材料、封装设备、清洗设备、激光加工机、EMS/电子代工服务、清洁/静电防护器材、工厂/厂房设备

电子零部件检测设备及开发技术展ELECTROTEST JAPAN：

各种检测设备、X射线检测设备、测试仪器、分离设备/软件、可靠性/评估检验设备、CCD相机、无损检测设备、合同分析服务

电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging Technology EXPO :

装配设备、包装材料/组件、IC封装分析/模拟软件、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

电子元件及材料展 ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS EXPO :

接线器、线缆、传感器、接线端子、电源开关、电阻器、转换器、电路安装材料、纳米技术材料

印刷电路展 PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo :

装配设备、保证材料/组件、IC封装分析/模拟软件、半导体器件/检测设备、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO:

冲压加工、切削/钻孔、精密/微细钣金加工、金属成型、电铸、精密铸造、镜面磨削、镭射加工、注塑、难切削材料加工

我司组展优势：

- 1、良好的摊位位置和价格优势。
- 2、境外行程和酒店食宿等安排一向优惠合理便捷，得到广大参展商和商务考察企业单位的****！
- 3、常年操作外展经验和熟悉当地国家情况的带团人员。
- 4、从摊位确认到展台搭建及展览品运输和商务签证培训与补贴办理，公司一条龙的砖业服务理念，打造展览服务行业第一品牌！

日本在半导体材料领域一直有风向标的作用。在新型的功率半导体材料氧化镓方面，日本也有望引起新一波潮流。根据日本Yano研究所市场报告预测，2025年氧化镓晶圆衬底将部分替代SiC、GaN材料，市场规模可达到2600亿日元；而据市场调查公司富士经济于2019年6月5日公布的Wide Gap功率半导体元件的全球市场预测来看，2030年氧化镓功率元件的市场规模将会达到1542亿日元，整个氧化镓市场容量将随着功率电子的发展呈现井喷式和跨越式发展。